



202319016950



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12524

检 测 报 告

样品名称：_____ 集成电路 _____

型号规格：_____ XCF01SVOG20C _____

器件品牌：_____ XILINX _____

委托单位：_____

深圳市创芯在线检测服务有限公司

2025 年 11 月 17 日



检 测 报 告

公司：

地址：

样品名称：集成电路

型号：XCF01SVOG20C

器件品牌：XILINX

批次代码：20+

器件封装：TSSOP-20

样品数量：1 片

检测数量：1 片

收样日期：2025/11/12

测试日期：2025/11/13/10:00 - 2025/11/14/18:00

报告专用章

检 测 _____

审 核 _____

批 准 _____



测试项目及结论

结果分析				结论
根据委托方要求，对所送1只样品进行了X射线检查共1项检验。 未检验到标准缺陷。				✓
测试项目	总数量（片）	检测标准	结果	
<input checked="" type="checkbox"/> 文件与包装检查	1	N/A	✓	
<input type="checkbox"/> 外观检测	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 丙酮测试	N/A	N/A	N/A	
<input checked="" type="checkbox"/> X-ray检测	1	GJB 548C-2021 方法 2012.2	✓	
<input type="checkbox"/> XRF检测	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 电特性测试	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 编程烧录	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 关键功能测试	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 声学显微镜检查	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 可焊性测试	N/A	N/A	N/A	
<input type="checkbox"/> 开盖测试	N/A	N/A	N/A	

结果状态：

✓ 可接受

✗ 不可接受

● 可疑的

N/A 未测试&不适用



测试设备

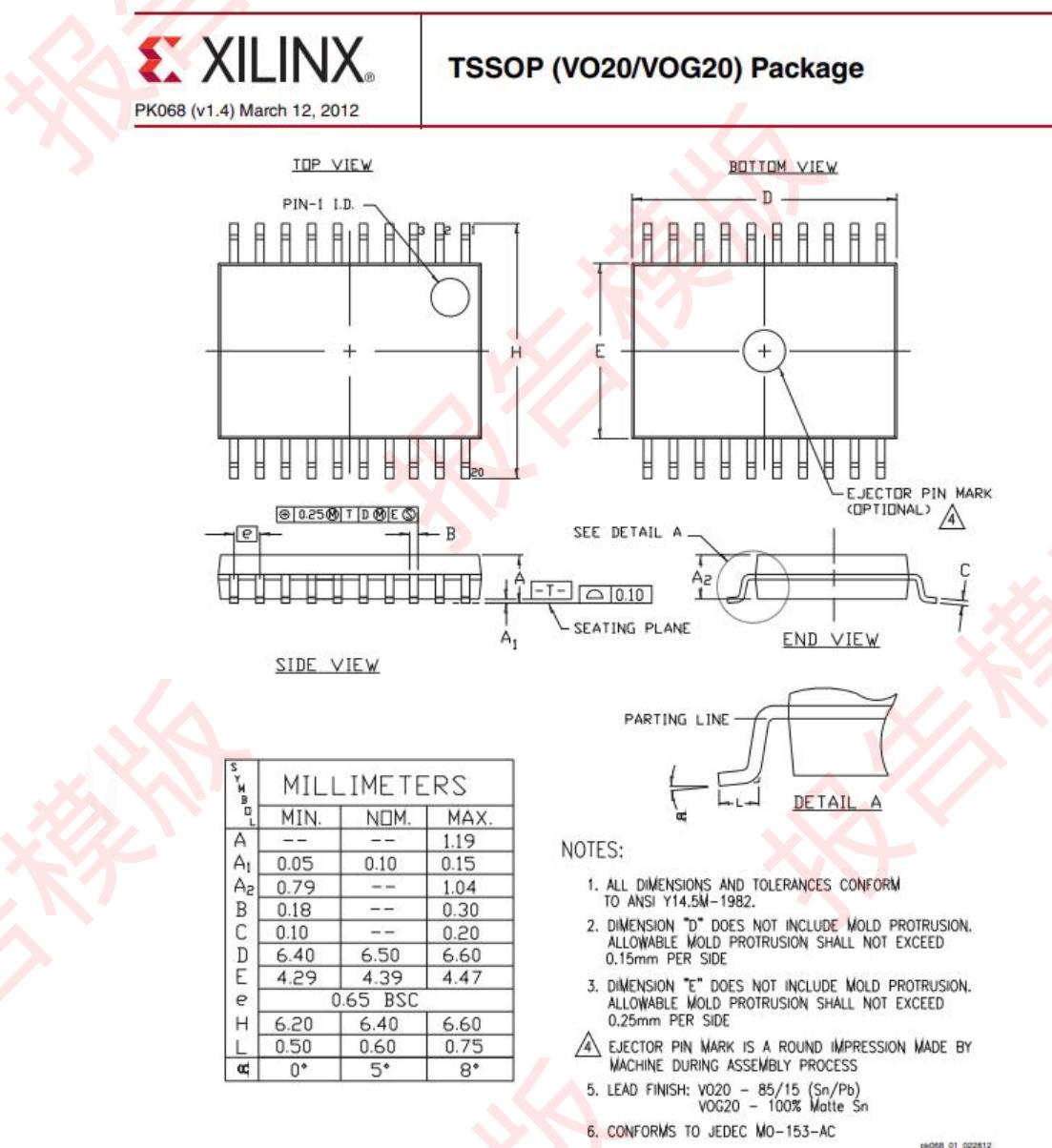
设备名称	编号	型号	校准有效期至
光学显微镜	TC-S-WG-007	SEZ-260	2026/07/07
X-射线探伤机	TC-S-WS-001	X6600	N/A
检测依据 《XILINX XCF01SVOG20C》：			
https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds123			



1. 芯片描述：

Xilinx推出了Platform Flash系列系统内可编程配置prom。这些prom提供1到32 Mb的密度，为存储大的Xilinx FPGA配置位流提供了一种易于使用、经济高效且可重新编程的方法。平台Flash PROM系列包括3.3V XCFxxS PROM和1.8V XCFxxP PROM。

2. 封装尺寸：





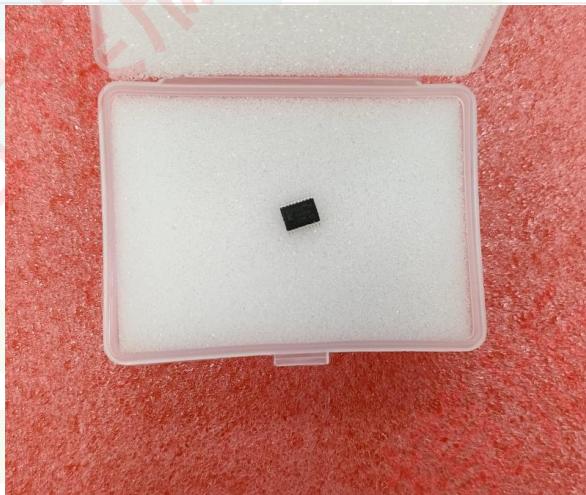
3. 文件与包装检查：

外箱数量	N/A	外箱尺寸 (cm)	N/A
内箱数量	N/A	内箱尺寸 (cm)	N/A
总重量	15 g	批次	20+
产地	N/A	批号	N/A
来料数量	1片	采样数量	1片
防潮保护	N/A	ESD保护	N/A
样品编号(批次+序号)	20+-#1		

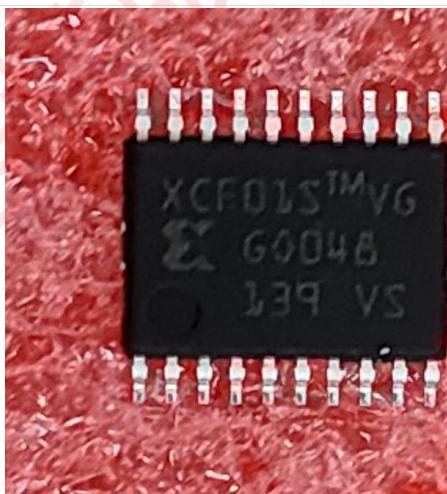
来料图片-1



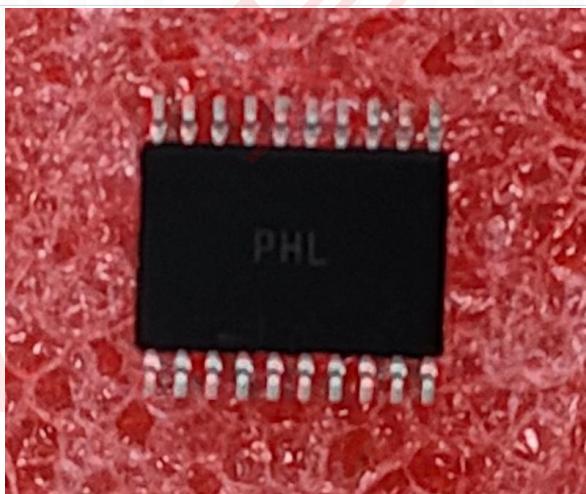
来料图片-2



来料图片-3



来料图片-4



4. X-ray检测：

依据标准：**GJB 548C-2021 方法 2012.2**

环境温度：25±3 °C 相对湿度：45%~65% RH

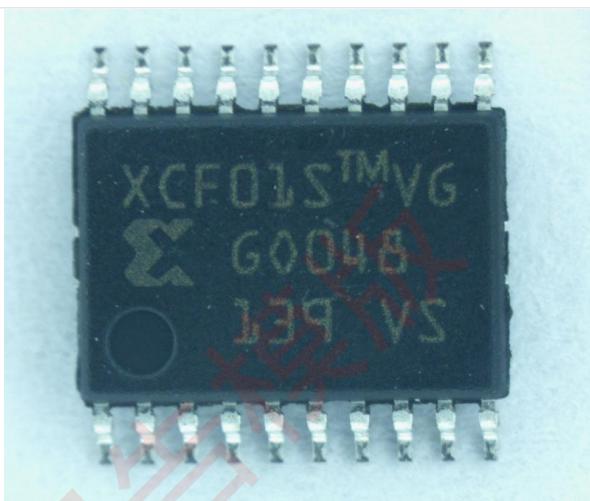
客户提供制造商为 **XILINX** 型号 **XCF01SVOG20C** 的 1 片用于分析，1 片样品（#1）进行 X-Ray 测试。详情如下：

X-Ray 检测样品 1 片，未发现键合丝及结构异常。1 片样品 X-ray 检测通过。

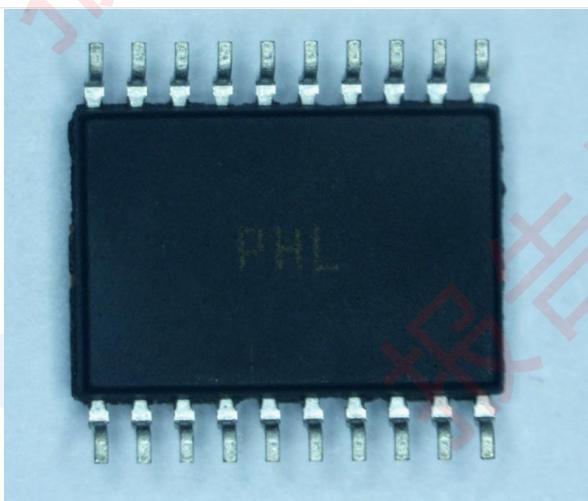
样品编号	检查项目	结果
#1	内部晶圆是否存在裂纹、粘接倾斜或超出粘接范围的异常	通过
	内部键合丝是否断裂、交丝、弧度超标、焊点脱焊异常	通过
	内部引线架和基板结构是否异常	通过
	内部粘接界面的空洞是否异常，是否存在粘接料与主体分离，粘接料累积过高异常	通过
	侧视图内部的粘接料爬升高度、键合丝弧度、键合丝与顶部间距、一二焊点是否存在异常	通过
	样品内部是否存在超出0.025mm的附着或游离颗粒物，是否为金属材质	通过



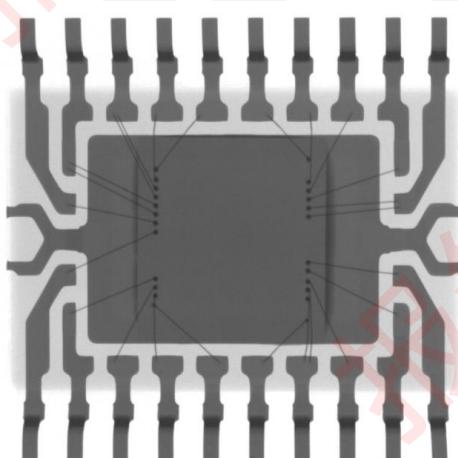
正面



背面



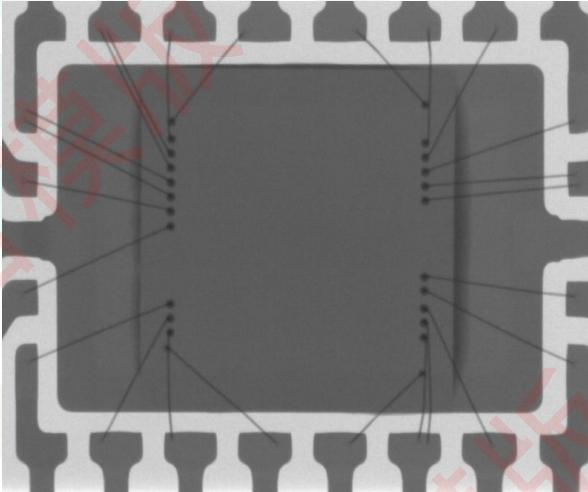
#1-正面形貌



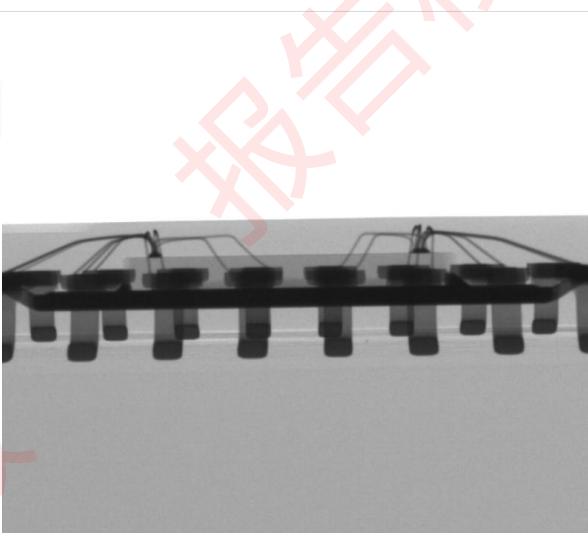
#1-侧面形貌



#1-正面放大形貌



#1-侧面放大形貌

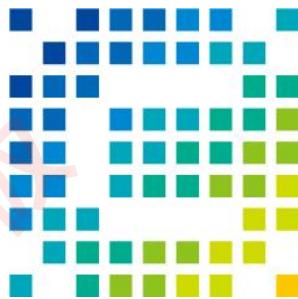




-报告结束-

声 明

1. 检测报告无“公司报告章”及“骑缝章”无效。
2. 复制检测报告未重新加盖“公司报告章”及“骑缝章”无效。
3. 检测报告中无检测、审核、批准人签字视为无效。
4. 检测报告涂改、部分提供和部分复制无效。
5. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 检测报告仅对收样检测结果负责，不对批量产品质量负责。
7. 加*者为分包检测数据。
8. 报告加盖 CMA 标识，表示检测项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 标识，表示部分/全部检测项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供委托方内部使用。



CXO 实验室公众微信号

电话：0755-83762185

邮箱：engineer@iclabcn.com

网站：<https://www.iclabcn.com>

地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路393号英达丰工业园A栋2楼